

【原因、判断要点、发生工序】焊料の銅含量太多等，成分異常所引起的（HAL 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by anomalies in solder composition such as excessive copper content (HAL process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

4-3-1-4 組成異常はんだブリッジ／成分異常的桥接 / Solder bridge by improper solder composition

【特徴】端子間にはんだがブリッジ状に跨っている状態の欠陥

【特征】桥接横跨插脚之间的缺陷。

【Characteristics】There is a solder bridge between edge board contacts.

【原因・判断ポイント・発生工程】銅含有量過多などのはんだ組成異常により出来たもの（HAL 工程）

【原因、判断要点、发生工序】焊料の含銅量太多等，成分異常所引起的（HAL 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

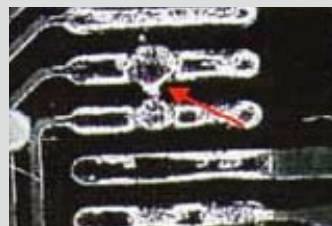
The defect is caused by improper solder composition such as excessive copper content (HAL process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×